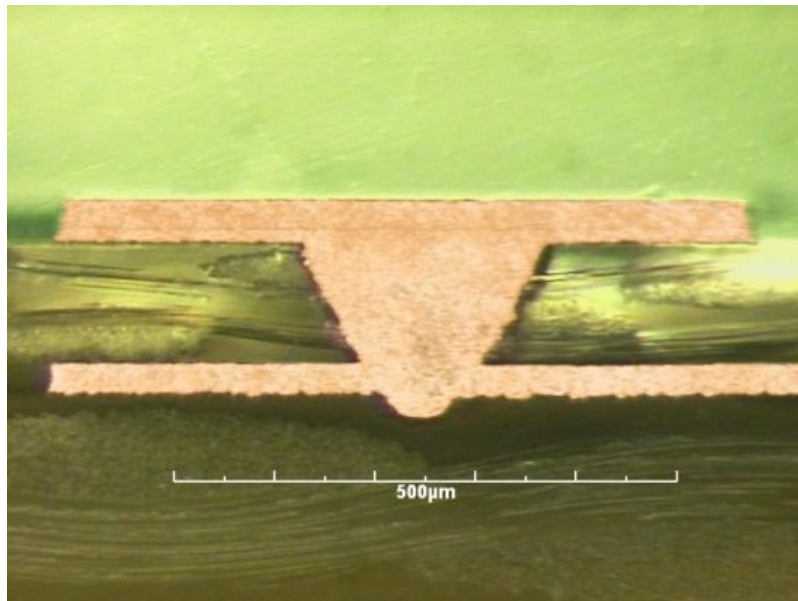


Durchbruch bei kupfergefüllten HDI-Microvias

22.12.2008, 13:55 | Industrie, Bau & Immobilien

Pressemitteilung von: *ANDUS ELECTRONIC GmbH*



kupfergefülltes HDI-Microvia

ANDUS hat einen neuen inhouse-Prozess zum galvanischen Verfüllen von Microvias qualifiziert, der insbesondere die Kombination von FinePitch-Bauelementen mit der Microleitertechnik ermöglicht. Die neuen, von außen nicht mehr sichtbaren Microvias erlauben die Entflechtung von µBGAs ohne Zugeständnisse an die Leiterbahnbreite.

Die neuen HDI-Microvias weisen zwei entscheidende Vorteile auf:

- Die Schichtdicke des Basiskupfers wird im Prozess nicht verändert. Das ist wichtig, um auch auf der Außenlage Microleiter von bis zu 50 µm Breite erzeugen zu können. Im Bild wurde die verwendete 12 µm Basisfolie per Ätzenschliff sichtbar gemacht.
- Die Microvias sind komplett mit massivem Kupfer gefüllt. Zum einen ist dadurch die Zuverlässigkeit der Verbindung gegenüber thermomechanischem und mechanischem Stress höher. Zum anderen begünstigt der hohe Kupferanteil die Wärmeleitung.

Portrait

Die Firma ANDUS ELECTRONIC GmbH hat sich auf die Herstellung von Leiterplatten in kleinen Stückzahlen im High-

Tech-Bereich spezialisiert. Es werden alle Technologien angeboten, die den Bedürfnissen des anspruchsvollen Kundenkreises entsprechen. Hierfür setzen sich die hochqualifizierten ANDUS-Ingenieure und -Techniker ein.

ANDUS fertigt in erster Linie für den professionellen Leiterplattenbedarf, überwiegend für die Bereiche:

- Luft- und Raumfahrt
- Medizintechnik
- Automotive
- Industrieelektronik
- Prüf- und Messtechnik

Neben den Standardtechnologien fertigt ANDUS insbesondere Technologien für High-Tech-Anwendungen, unter anderem:

- Flex- und Starrflex-Leiterplatten
- HDI-Leiterplatten (mit Microvias und Buried Vias)
- HF-/Impedanz-Leiterplatten
- Hochlagige Multilayer mit Dünnlaminaten
- Heatsink zur Wärmeableitung
- Feinstleiterstrukturen $\geq 50\mu$

Die Firma ANDUS wurde 1969 gegründet und beschäftigt 65 Mitarbeiter.

News-ID: 269774 • Views: 1041 (Stand: 07.08.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/269774/Durchbruch-bei-kupfergefüllten-HDI-Microvias.html>